

# ((rfid))-HighTemp

## RFID Label für hohe Temperaturen

*In der Industrie werden Behälter und Produkte in verschiedenen Prozessschritten hohen Temperaturen ausgesetzt. Sei es beim reinigen oder lackieren – eine hohe Temperaturfestigkeit des Datenträgers ist gefordert. Das ((rfid))-HighTemp Label von Schreiner LogiData berücksichtigt diese Anforderungen und kann für die Prozesse verlässlich zur Identifikation eingesetzt werden.*



### Einsatzgebiete

Für diese Applikationen ist das ((rfid))-HighTemp Label ideal:

- Ladungsträgeridentifikation  
Reinigungsprozesse von Behältern und Fässern
- Lackierstrassen  
SKID Identifikation
- Lebensmittelverpackungen

### Produktnutzen

Das ((rfid))-HighTemp Label von Schreiner LogiData erlaubt die Identifikation von Produkten und Ladungsträger mittels RFID vor und nach Prozessschritten mit hohen Temperaturen. Das Label lässt sich direkt auf unterschiedliche Oberflächen aufbringen und aus mittlerer Distanz auslesen.

### Kundenindividuelle Anpassung

Für Ihre Applikation kann das ((rfid)) HighTemp-Label angepasst werden. Die Kombination von RFID mit Barcode, Klarschrift und Logos sowie die Integration weiterer Sicherheitsmerkmale ist unser tägliches Geschäft.

## Technische Details

Allgemein	
Abmessungen (Standard)	100 mm x 40 mm
Dicke	1000 µm
Betriebsumgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Temperatur Prozess	+220°C für 30 min
RFID	
Frequenzbereich	865...870 MHz (Europa) 902...928 MHz (USA)
Protokoll	ISO 18000-6 C EPC Class 1 Gen2
IC	Impinj Monza 3, NXP UCODE G2XL / G2XM
Speicher	96 bit EPC, 240 bit EPC, 240 bit EPC + 512 bit user memory
Typische Reichweite	3 m
Zusatzmerkmale	
Sicherheit	Sicherheitsmerkmale Kennwort für RFID Speicher Manipulationsschutz
Barcode	alle 1D und 2D Codes
Sonstiges	Logos und Klarschrift

Weitere Varianten bezüglich Abmessungen, Speicher und Merkmalen auf Anfrage lieferbar. Alle Produkte sind RoHS konform.

### Alles aus einer Hand

Als bewährter Entwicklungspartner für hochwertige RFID-Lösungen unterstützt Sie Schreiner LogiData von der Technologieberatung über Machbarkeitsstudien, die Erstellung von Pflichten- und Lastenheften, die Auswahl geeigneter Hard- und Softwarekomponenten, die Fertigung von Produkten mit integriertem Transponder und die Integration in eine bestehende Systemlandschaft bis hin zum qualifizierten After-Sales-Support.

